



图片 特点:

输出频率: 1000MHz

输出频率准确度: ≤±20ppm

输出功率: 典型值≥+13dBm

相位噪声: -95 dBc/Hz@10kHz

杂散分量: -60dBc

封装尺寸: 20.32*15.24*4.57mm3

产品执行标准为 GJB8481-2015

性能参数: (TA=25℃)

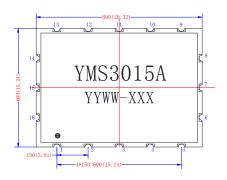
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX	1 平仏	番任
输出频率	f _{out}			1000		MHz	
频率准确度	FS	输出端口阻抗: 50Ω - 工作电压: 5V - (相噪测试: @ 10KHz)	-20		20	ppm	
输出功率	Pout		+13	15		dBm	
杂散抑制	SR		60	65		dBc	
谐波抑制		(相架例以: @10代12)	40	50		dBc	
相位噪声	PN			-103	-95	dBc/Hz	
电源电压	Vcc		+4.75	+5	+5.25	V	
电源电流	Icc			200	220	mA	

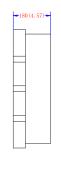
极限参数表:

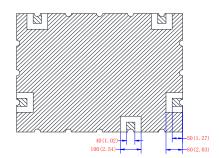
参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
电源电压	+6	V	工作温度	-55∼+85	$^{\circ}$
贮存温度	-60∼+105	$^{\circ}$			

封装外形图:

单位: mm 公差: ±0.2mm











字符标志:

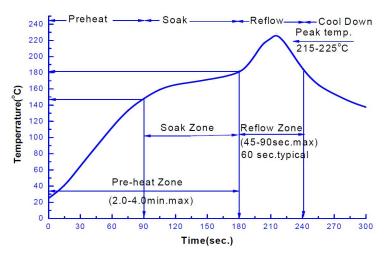
YMS3015A	产品型号		
•	1 脚		
YYWW	批次号		
XXX	序列号		

引脚定义:

引脚序号	定义	备注
2	NC	悬空
6	RF OUT	射频输出
9	Vcc	+5V
13	REF in	10M 参考信号输入
16	LD	锁定指示
1/3/4/5/7/8/10/11/12/14/15	GND	接地

产品使用注意事项:

- 1. 产品属于静电敏感器件,产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护;
- 2. 产品禁止采用超声波清洗,避免内部元器件及焊点受力出现开裂影响可靠性。
- 3. 产品使用时请保证接地良好(GND引脚和底部金属化区域);
- 4. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用,采用 Sn63/Pb37 锡膏回流焊接,回流温度推荐曲线:



此图为推荐回流温度曲线,因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线, 实测回流基板温度不得超过 230℃。

- 5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装,存放条件:温度 10~35℃,湿度 35~65%RH;对于需长期储存(超过半年)产品尽量在充氮干燥环境下存放。
- 6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境,客户在对产品焊接及清 洗完成后,应对宇熙产品进行三防喷涂处理,以提高产品耐环境适应性能力。